

Transfer Molding System

Model EZS1120



**Transfer molding system suitable for
small volume production of multiple products**

适用于多种产品的小批量生产的注塑成形设备

产品信息



中文

- 通过使用工具切换治具，实现KIT交换的简单化和模具设计的统一化，从而提高模具及设备的品种交换效率
- 经凑得设计使得设备移动更容易实现
- 可对应大尺寸Package等产品，对应范围更广泛



SPECIFICATION

Items		Unit	Description
机型		—	EZS1120
框架・基板类型		—	基板・引线框架
框架・基板尺寸	长度	mm	150—300
	宽度	mm	15—100
树脂	径	mm	φ 13, 14, 16, 18, 20
	长度	mm	14.3—35.0
机械时间		sec	Approximately 60
外形尺寸	模组数量	module	1
	宽度	mm	1,400
	纵深	mm	1,380
	高度	mm	1,880
重量		ton	3.5
每模成形框架数量		workpiece	1
进料盒空间		mm	1 pce: 20—110(W) × 160—310(L) × 170(H)
出料盒数量 (堆叠式收料方式)		pcs	1
合模压力		kN／(tf)	196.0—1,176.0／20.0—120.0
注塑压力		kN／(tf)	3.9—98.0／0.4—10.0 (2 step pressure setting)
品种切换方式		—	采用KIT更换方式
可以安装的模具		—	EZS1120租用模具

- ・以上数据为本公司标准机型时的规格
- ・以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- ・如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters TOWA Corporation	Philippines TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.
China TOWA (Shanghai) Co., Ltd. TOWA Taiwan Co., Ltd.	Thailand TOWA THAI COMPANY LIMITED
Korea TOWA Korea Co., Ltd.	India TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED
Singapore TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.	Germany TOWA Europe GmbH
Malaysia TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.	Netherlands TOWA Europe B.V.
	the United States TOWA USA Corporation